

経済産業委員会 質問要旨

2025 年 4 月 9 日

立憲民主党 階 猛

1. AI・半導体基板強化フレームにつき、つなぎ国債の償還原資を財投特会投資勘定から繰り入れる理由
2. 上記繰り入れは財投特会投資勘定の趣旨に反するのではないか
3. 上記繰り入れが将来の財投特会投資勘定の出資・収益確保につながる保証はあるのか
4. 上記繰り入れ額が総額で2.2兆円程度とされる理由
5. つなぎ国債の償還原資は、現物出資や金融支援によって得られる利益から捻出すべきではないか
6. その他、これまでの委員会質疑に関連する質問

※ 答弁者は、経済産業大臣および財務省政府参考人

以 上

・ 配布資料がある場合は、追って提出